

# SHIELD COMPOUND

## シールド・コンパウンド

1液または2液性の  
室温硬化型、熱硬化型、湿気吸収硬化型  
導電性エポキシ/シリコン接着&コーキング剤です。

### エポキシ系接着剤の特長

エポキシ系 CHO-BOND, 584-29, 584-208, 592, 360-20, 360-208 は、導電性の充填材を含んだエポキシ接着剤です。接着力に優れ、速乾性に優れています。

#### ■ CHO-BOND 584-29, 584-208, 592

この銀充填材料は公差の厳しい接着ラインを要求される個所で使用されます。様々な硬化方法を利用して、コーキング・ガンやへら、ニードル実装、シルクスクリーン法を使っての容易に実装できます。メッシュ・ガスケットの接着、プリント回路基板の補修、チップ・ボンディング、リア・ウィンドーの防霜装置の補修、低温下での柔軟な半田と同様に利用できます。

#### ■ CHO-BOND 360-20, 360-208

この製品は公差の大きい表面へ接着するのに最適な大きな銀メッキ銅粒子 (> 50 ミクロン) を採用しています。接着層は 0.25mm 以上でも接着可能です。砂のようなフィラーが酸化皮膜やアロジンコーティング (黄色) 等の薄い絶縁層を突き破り導通します。用途は鋳造アルミ筐体、コンジット隔壁の開口部、フィルター、キャビネットのシールドリングや接着を含みます。注) 上記のコンパウンドは継ぎ目としての接着には使用しないでください。



### シリコン系接着剤の特長

シリコン系 CHO-BOND 1029, 1030, 1035, 1075 は、導電性の充填材を含んだシリコン接着剤です。各接着剤はそれぞれ様々な厚さで塗布でき、接着箇所は柔軟性が持たせられます。

#### ■ CHO-BOND 1029 RoHS対応品

2液性の高導電性接着剤で、導電性エラストマーと薄くプライマーを塗布した金属面との接着に適します。接着層は0.2mm以下で有効です。

#### ■ CHO-BOND 1030 RoHS対応品

1液性の高導電性 RTV (室温硬化型) 接着剤で、非酢酸タイプです。接着層は約0.25mm以下で有効です。

#### ■ CHO-BOND 1035 RoHS対応品

1液性の高導電性 RTV (室温硬化型) シーラント剤で、広範囲な使用温度範囲で柔軟なシールドリング機能を発揮します。

#### ■ CHO-BOND 1075 RoHS対応品

1液性の高導電性接着剤/シーラント剤です。特にシールド・ラバー2及びシールド・シート2の1285材との相性が良く、電食の心配がありません。

#### ■ プライマー 1086 RoHS対応品

1030、1038、1075 用プライマー

# SHIELD COMPOUND

## シールド・コンパウンド

### ■製品別特性〔エポキシ接着剤〕

種類	584-29	584-208	592	360-20	360-208
バインダー	エポキシ	エポキシ	エポキシ	エポキシ	エポキシ
フィラー	銀	銀	銀	銀/銅	銀/銅
混合率	100:6.3	1:1	100:50	1:1	100:33
粘度状態	薄いペースト状	ペースト状	ほぼ液状	ペースト状	厚いペースト状
比重	2.5 ± 0.20	2.7 ± 0.30	2.6 ± 0.25	5.0 ± 0.30	4.0 ± 0.40
最小ラップシアー 接着強度, psi (MPa)	1200 (8.28)	700 (4.83)	1500 (10.35)	1600 (11.04)	1400 (9.66)
最小ダイシアー 接着強度, psi (MPa)	-	-	-	-	-
最大 DC 体積抵抗, Ω -cm	0.002	0.005	0.05	0.005	0.01
使用温度範囲	-55 ~ 125°C	-62 ~ 99°C	-62 ~ 99°C	-62 ~ 100°C	-62 ~ 100°C
接着条件, 加熱, 室温	15分 @113°C	45分 @100°C	30分 @100°C	2時間 @66°C	45分 @100°C
	24時間	24時間	1週間	24時間	24時間
使用期限	0.5時間	1時間	4時間	1時間	1時間
保管期限, 月	9	9	9	9	9
塗布面積の目安 cm <sup>2</sup> /g	156.1	141.9	170.3	7.1	9.9
推奨塗布厚, mm	0.025 min.	0.025 min.	0.025 min.	0.25 min.	0.25 min.
揮発性有機化合物 VOC, g/liter	0	0	47 (A&B)	0	0
用途	基板の補修 ガスケットの接着	異種材料の接着	静電対策用	異種材料の接着	導電接合

### ■製品別特性〔シリコン接着剤〕

種類	1029	1030	1035	1075	1085	1086
バインダー	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	1029用 プライマー	1030, 1035, 1075用プライマー
フィラー	銀/銅	銀/銅	銀/ガラス	銀/アルミ		
混合率	1.0:2.5	1液性	1液性	1液性	1液性	1液性
粘度状態	厚いペースト状	砂状ペースト	薄いペースト状	ペースト状	液状	液状
比重	3.0 ± 0.35	3.75 ± 0.25	1.9 ± 0.10	2.0 ± 0.25	0.87 ± 0.15	0.78 ± 0.10
最小ラップシアー 接着強度, psi (MPa)	450 (3.11)	200 (1.38)	100 (0.69)	100 (0.69)	NA	NA
最大 DC 体積抵抗, Ω -cm	0.06	0.05	0.05	0.01	NA	NA
使用温度範囲	-55 ~ 125°C	-55 ~ 200°C	-55 ~ 200°C	-55 ~ 200°C	-80 ~ 200°C	-80 ~ 200°C
接着条件, 加熱, 室温	30分 @121°C	NA	NA	NA	NA	NA
	1週間	1週間	1週間	1週間	30分	30分
使用期限	2時間	30分	30分	15分	NA	NA
保管期限, 月	6	6	6	6	6	6
塗布面積の目安 cm <sup>2</sup> /g	25.5	18.5	21.3	17	NA	NA
推奨塗布厚, mm	0.20 max.	0.25 max.	0.18 min.	0.25 max.	0.13 min.	0.005 max.
VOC, g/liter	0	0	151	0	719	740
用途	EMI ガスケット接着	EMI ガスケット接着 標準品	コーキング剤	EMI ガスケット接着	プライマー	プライマー

### ■接着剤用オーダーリスト

製品	パートナンバー	サイズ	製品	パートナンバー	サイズ
CHO-BOND 584-29	50-10-0584-0029	1g CHO-PAK	CHO-BOND 1029	50-01-1029-0000	0.5kg
CHO-BOND 584-29	50-02-0584-0029	2.5g CHO-PAK	CHO-BOND 1029	50-00-1029-0000	85g
CHO-BOND 584-29	50-03-0584-0029	10g CHO-PAK			
CHO-BOND 584-29	50-01-0584-0029	0.5kg	CHO-BOND 1030	50-01-1030-0000	0.5kg
CHO-BOND 584-29	50-00-0584-0029	85g	CHO-BOND 1030	50-02-1030-0000	113g
CHO-BOND 584-208	50-01-0584-0208	0.5kg	CHO-BOND 1035	51-01-1035-0000	0.3kg
CHO-BOND 584-208	50-00-0584-0208	85g	CHO-BOND 1035	51-00-1035-0000	71g
CHO-BOND 592	50-01-0592-0000	0.5kg	CHO-BOND 1075	50-01-1075-0000	0.3kg
CHO-BOND 592	50-00-0592-0000	85g	CHO-BOND 1075	50-02-1075-0000	71g
CHO-BOND 360-20	50-01-0360-0020	0.5kg	プライマー		
CHO-BOND 360-208	50-01-0360-0208	0.5kg	CHO-BOND 1085	50-01-1085-0000	0.47liter
CHO-BOND 360-208	50-00-0360-0208	85g	CHO-BOND 1086	50-01-1086-0000	0.47liter

※在庫のご確認につきましては、最寄りの各営業所にお問い合わせください。

# SHIELD COMPOUND

## シールド・コンパウンド

### 導電性コーキング剤およびシーラント剤

#### ■ CHO-BOND 360-20, 360-208

この製品は公差の大きい表面へ接着するのに最適な大きな銀メッキ銅粒子 (> 50 ミクロン) を採用しています。接着層は 0.25mm 以上でも接着可能です。砂のようなフィラーが酸化皮膜やアロジンコーティング (黄色) 等の薄い絶縁層を突き破り導通します。用途は鋳造アルミ筐体、コンジット隔壁の開口部、フィルター、キャビネットのシールディングや接着を含みます。  
注) 上記のコンパウンドは継ぎ目としての接着には使用しないでください。

#### ■ CHO-BOND 1035

RoHS対応品

1液性の高導電性 RTV (室温硬化型) シーラント剤で、広範囲な使用温度範囲で柔軟なシールディング機能を発揮します。

#### ■ CHO-BOND 1038

RoHS対応品

1液性の高導電性 RTV シリコン接着剤/シーラント剤です。EMI シールドはもちろんのこと、環境シールドも実現できます。

#### ■ CHO-BOND 1075

RoHS対応品

1液性の高導電性接着剤/シーラント剤です。特にシールド・ラバー 2 及びシールド・シート 2 の 1285 材料との相性が良く、電食の心配がありません。

#### ■ CHO-BOND 4660, 4669

非硬化タイプのコーキング剤で、EMI シールディングの継ぎ目、パイプのネジ山などのコーキングに用います。ポリイソブチレン系樹脂に導電材として銀を充填しています。4669 は細密な銀粒子で信頼性が高く、4660 は銀粒子が大きめで低価格です。

### ■製品別特性

種類	360-20	360-208	1035	1038	1075	4660	4669	1086
バインダー	エポキシ	エポキシ	シリコン	シリコン	シリコン	ポリイソブチレン	ポリイソブチレン	1035,1038,1075 用プライマー
フィラー	銀/銅	銀/銅, 銀	銀/ガラス	銀/銅	銀/アルミ	銀/銅	銀/銅	
混合率	1:1	100:33	1 液性	1 液性	1 液性	1 液性	1 液性	1 液性
粘度状態	ペースト状	厚いペースト	厚いペースト状	ペースト状	ペースト状	砂状ペースト	砂状ペースト	液状
比重	5.0 ± 0.30	4.0 ± 0.40	1.9 ± 0.10	3.55 ± 0.35	2.0 ± 0.25	2.0 ± 0.30	2.0 ± 0.30	0.78 ± 0.10
最小ラップシアー 接着強度, psi (MPa)	1600 (11.04)	1400 (9.66)	100 (0.69)	120 (0.83)	100 (0.69)	NA	NA	NA
最大 DC 体積抵抗, Ω-cm	0.005	0.01	0.05	0.01	0.01	0.08	0.08	NA
使用温度範囲	-62 ~ 100°C	-62 ~ 100°C	-55 ~ 200°C	-55 ~ 125°C	-55 ~ 200°C	-55 ~ 100°C	-55 ~ 100°C	-80 ~ 200°C
キュア温度サイクル	2 時間 @66°C	45 分 @100°C	NA	NA	NA	NA	NA	NA
室温キュア時間	24 時間	24 時間	1 週間	1 週間	1 週間	1 週間	1 週間	30 分
使用期限	1 時間	1 時間	30 分	30 分	15 分	30 分	2.5 時間	NA
保管期限, 月	9	9	6	6	6	6	6	6
膨張性 cm <sup>2</sup> /g	7.1	9.9	21.3	10.6	17.0	12.8	12.8	NA
推奨塗布厚, mm	0.25 min.	0.25 min.	0.18 min.	0.18 min.	0.25 min.	0.38 min.	0.38 min.	0.005 max.
VOC, g/liter	0	0	151	117	0	323	361	740
用途	公差の大きい表面	公差の大きい表面	広範囲な温度域	EMI 十環境シールド	シールドシート 1285 との相性良好	非硬化タイプ 小さなフィラー	非硬化タイプ フィラー大きめ	プライマー

### ■コーキング用オーダーリスト

製品	パートナンバー	サイズ
CHO-BOND 360-20	50-01-0360-0020	0.5kg kit
CHO-BOND 360-208	50-01-0360-0208	0.5kg kit
CHO-BOND 360-208	50-00-0360-0208	85g kit
CHO-BOND 1035	51-01-1035-0000	0.3kg kit
CHO-BOND 1035	50-00-1035-0000	71g kit
CHO-BOND 1038	50-01-1038-0000	0.5kg kit
CHO-BOND 1038	50-02-1038-0000	113g kit
CHO-BOND 1075	50-01-1075-0000	0.3kg kit
CHO-BOND 1075	50-02-1075-0000	71g kit
CHO-BOND 4660	51-05-4660-0000	0.7kg カートリッジ
CHO-BOND 4660	51-02-4660-0000	113g チューブ
CHO-BOND 4669	51-05-4669-0000	0.7kg カートリッジ
CHO-BOND 4669	51-02-4669-0000	113g チューブ
プライマー CHO-BOND 1086	50-01-1086-0000	0.47 liter

※在庫のご確認につきましては、最寄りの各営業所にお問い合わせください。